



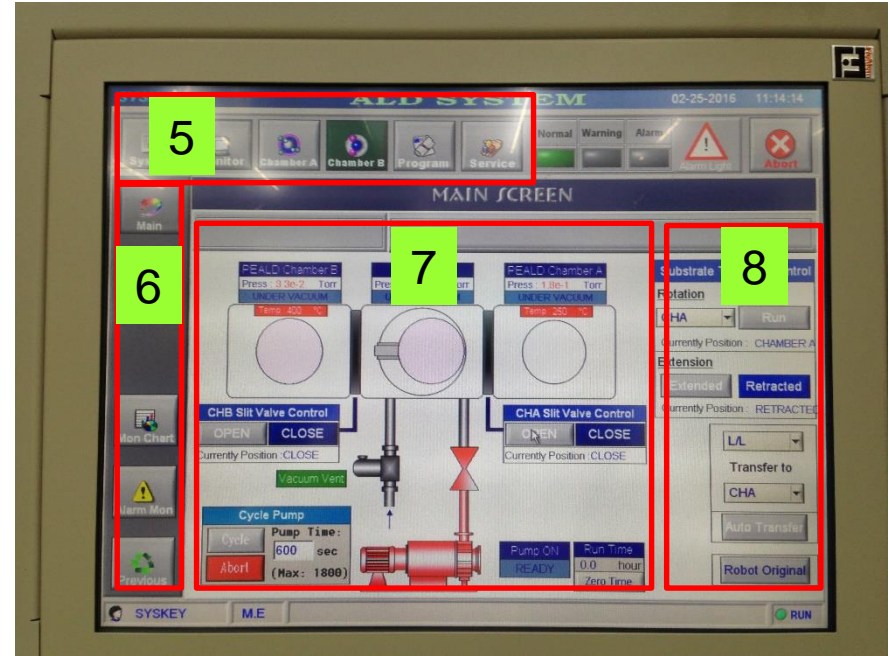
PEALD操作SOP

機台外觀及主頁面



機台外觀

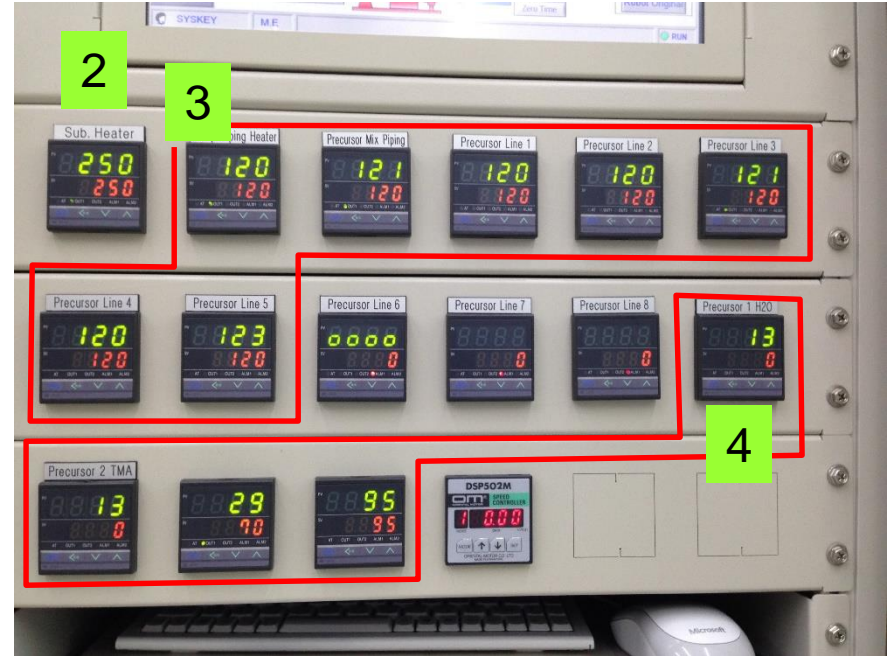
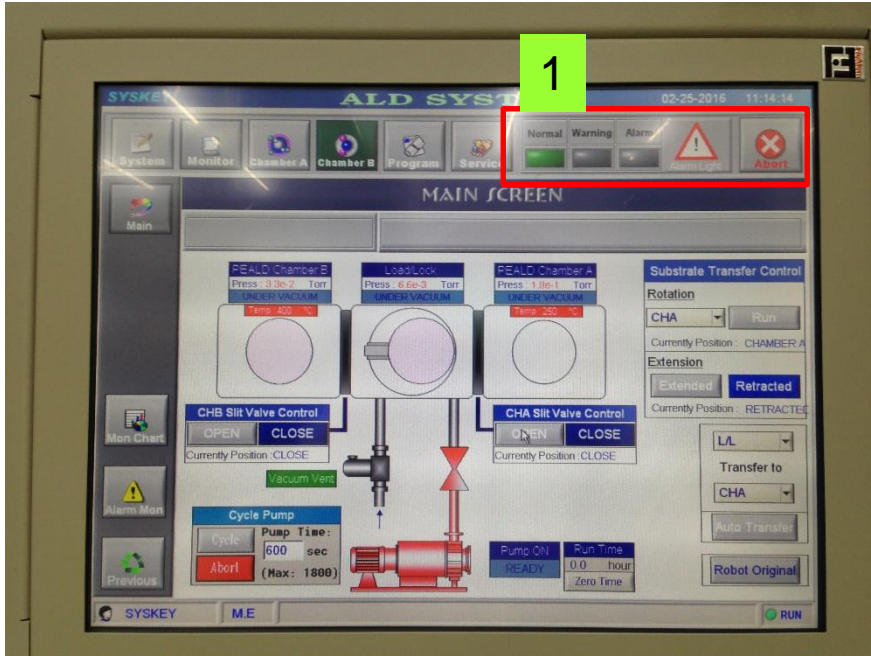
1. 系統控制及操作區
2. Load lock chamber
3. Chamber A (High k)
4. Chamber B (Metal)



主頁面

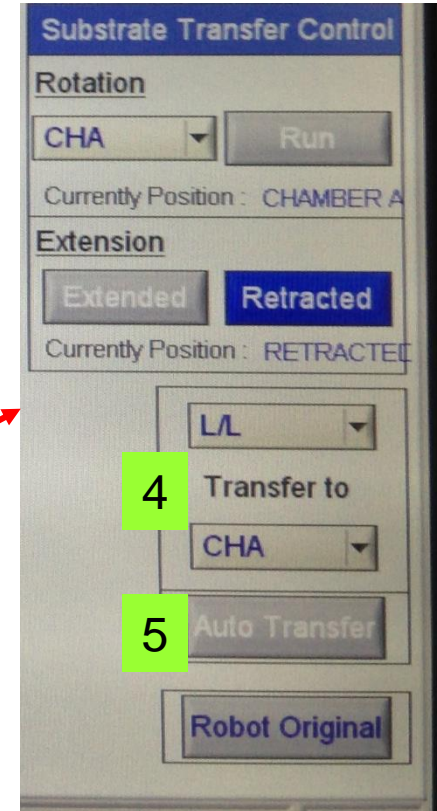
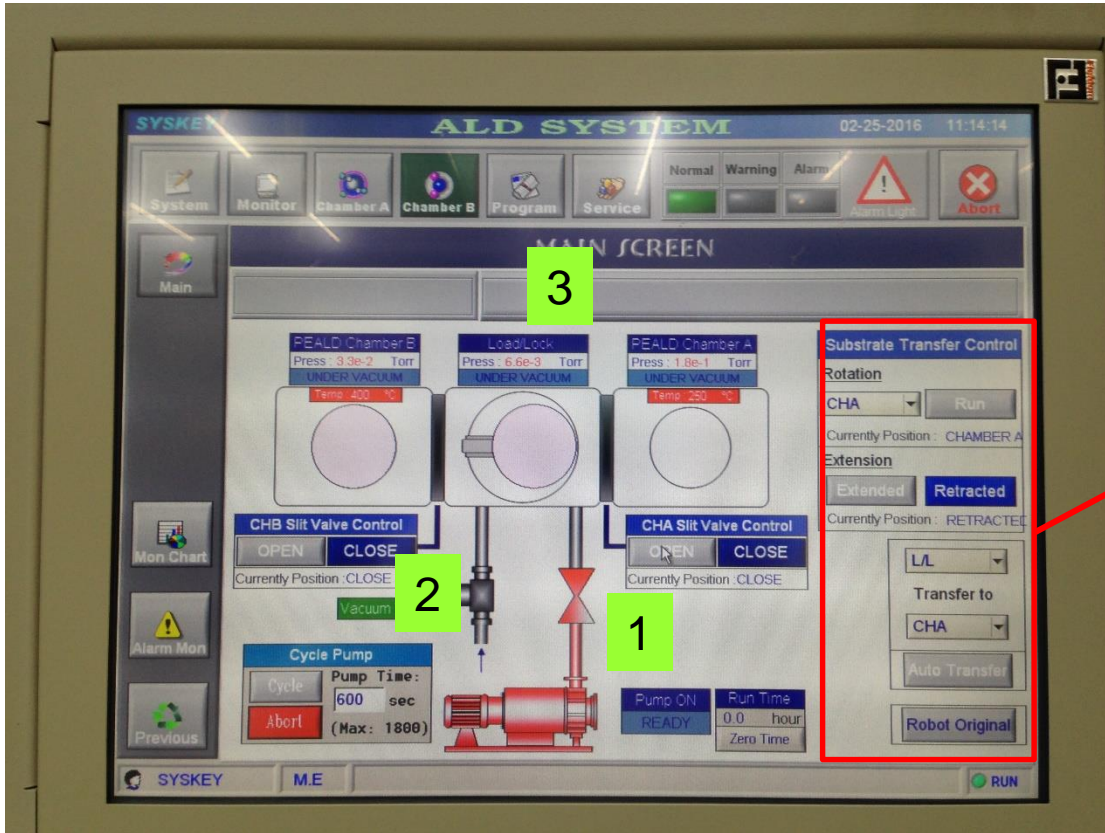
5. 功能選項目錄
6. 功能選項子目錄
7. 系統示意圖
8. Load lock控制選項

使用前注意事項



- 確認機台狀況為“Normal”，且無任何alarm訊息。
- 設定“Sub Heater”溫度。(Al₂O₃:250度、HfO₂: 320度、TEMAZ: 320度)
- 確認Pump/Gas line溫度為“120”度。
- 確認“Precursor”溫度。(Al₂O₃: 20度、HfO₂: 95度、TEMAZ: 85度)

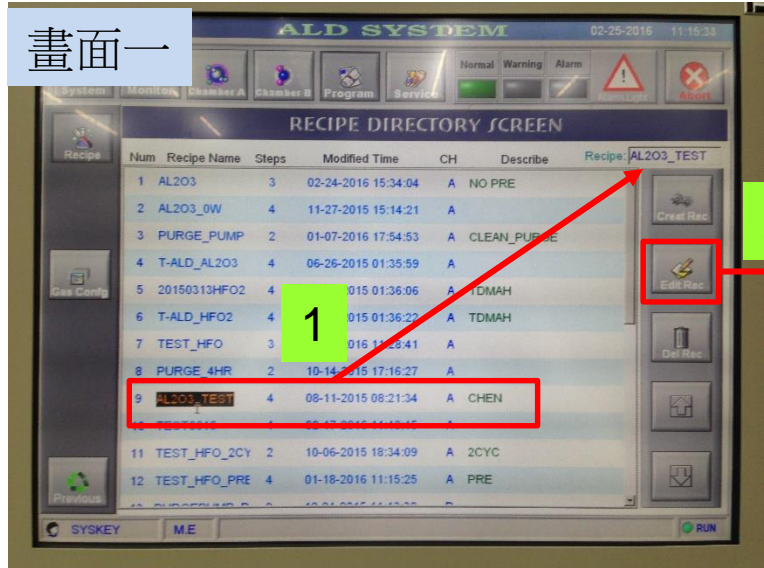
晶片放置及傳送



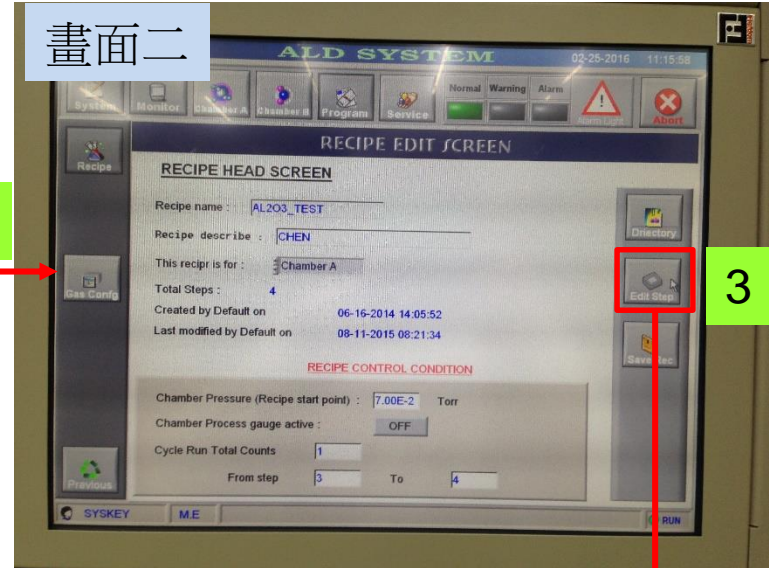
1. 點選“Pump valve”→“Close”。
2. 點選“Vent valve”→“Open”，確認壓力為“ATM”後，可開腔體，並置入晶片。
3. Vent valve→Close、Pump valve→Open，確認壓力為“5E-3 Torr↓”，可傳送晶片。
4. 選擇要傳送的位置。
5. 點選“Auto Transfer”開始傳送，完成後確認Robot arm上以無晶片。

製程參數編輯

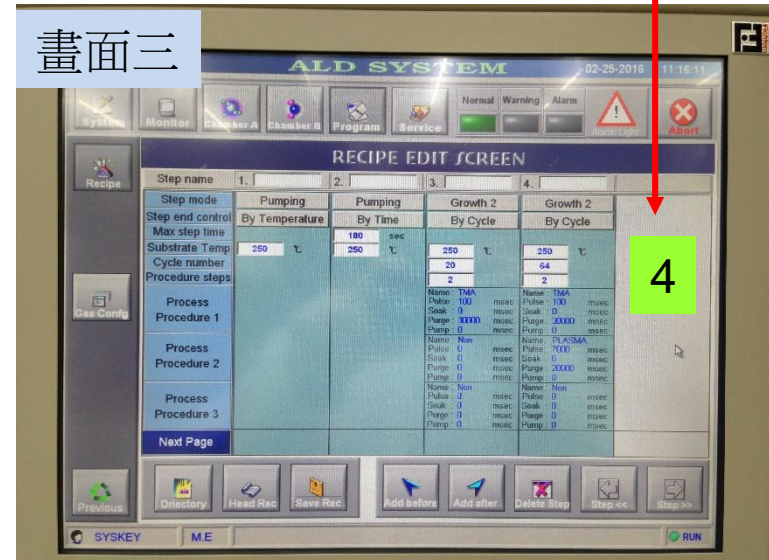
畫面一



畫面二



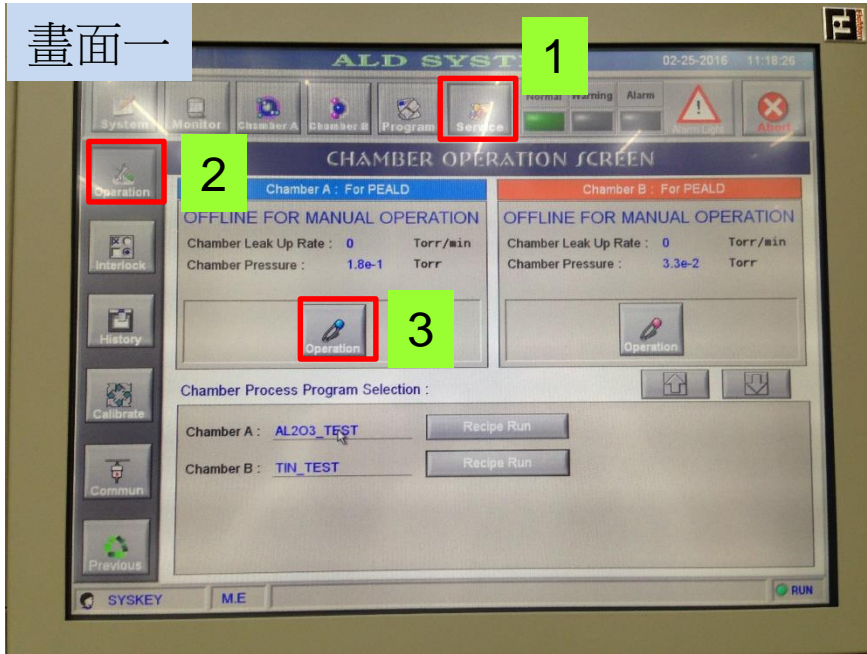
畫面三



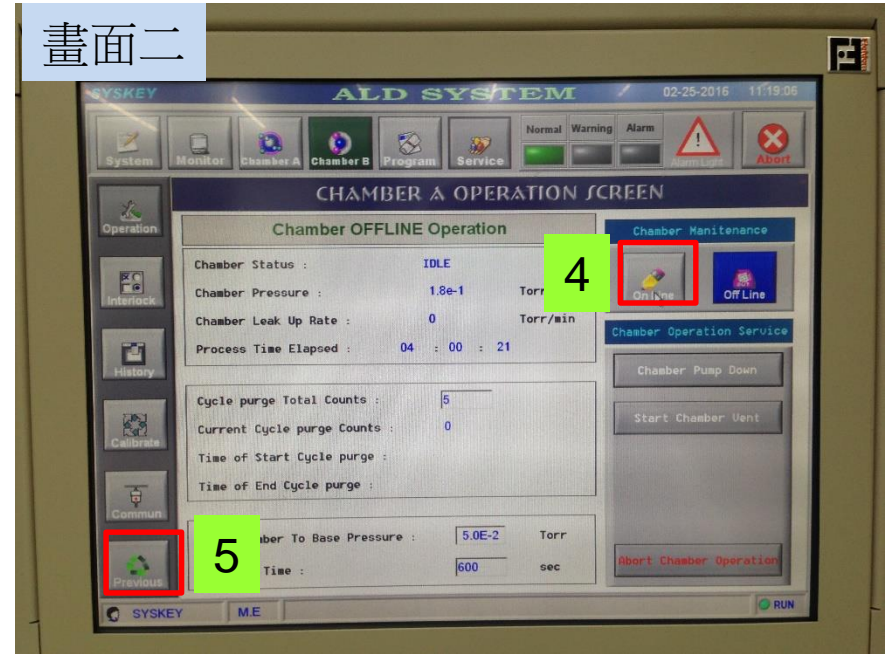
1. 點選程式名稱，並確認右上方名稱正確。
2. 點選“Edit Rec”進入畫面二。
3. 點選“Edit Step”進入畫面三。
4. 進行製程步驟編輯，完成後離開。

製程執行〔1〕

畫面一



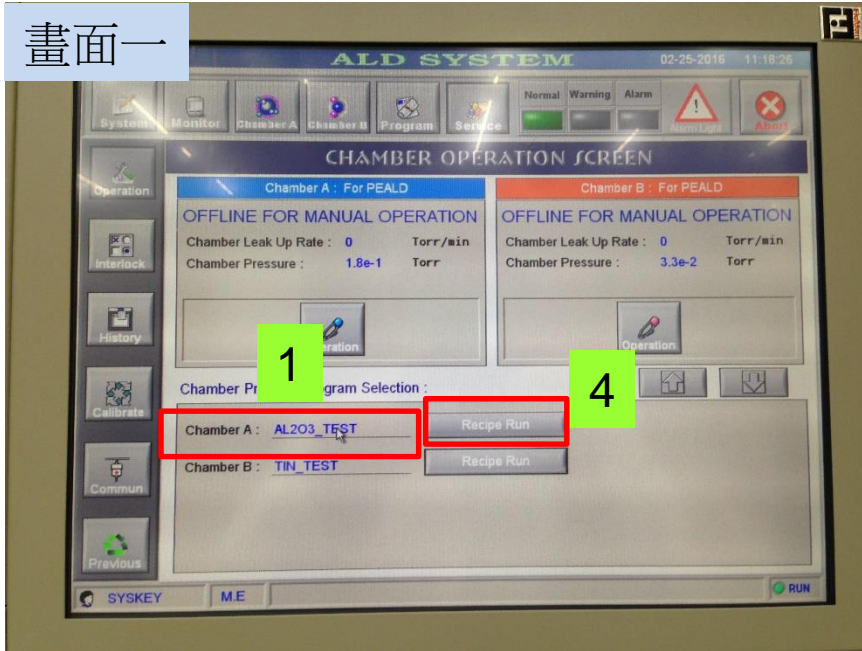
畫面二



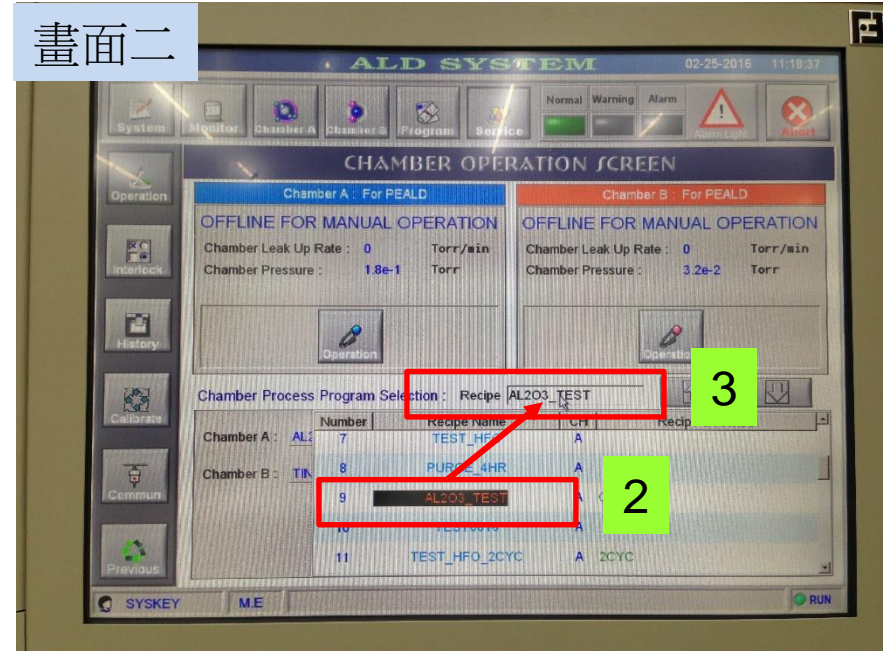
1. 點選功能選項目錄“Service”。
2. 點選功能選項子目錄“Operation”，進入Chamber operation screen。
3. 點選製程腔體“Operation”進入畫面二。
4. 點選“Chamber Maintenance”→“On Line”。
5. 點選功能選項子目錄“Previous”，返回畫面一。

製程執行〔2〕

畫面一

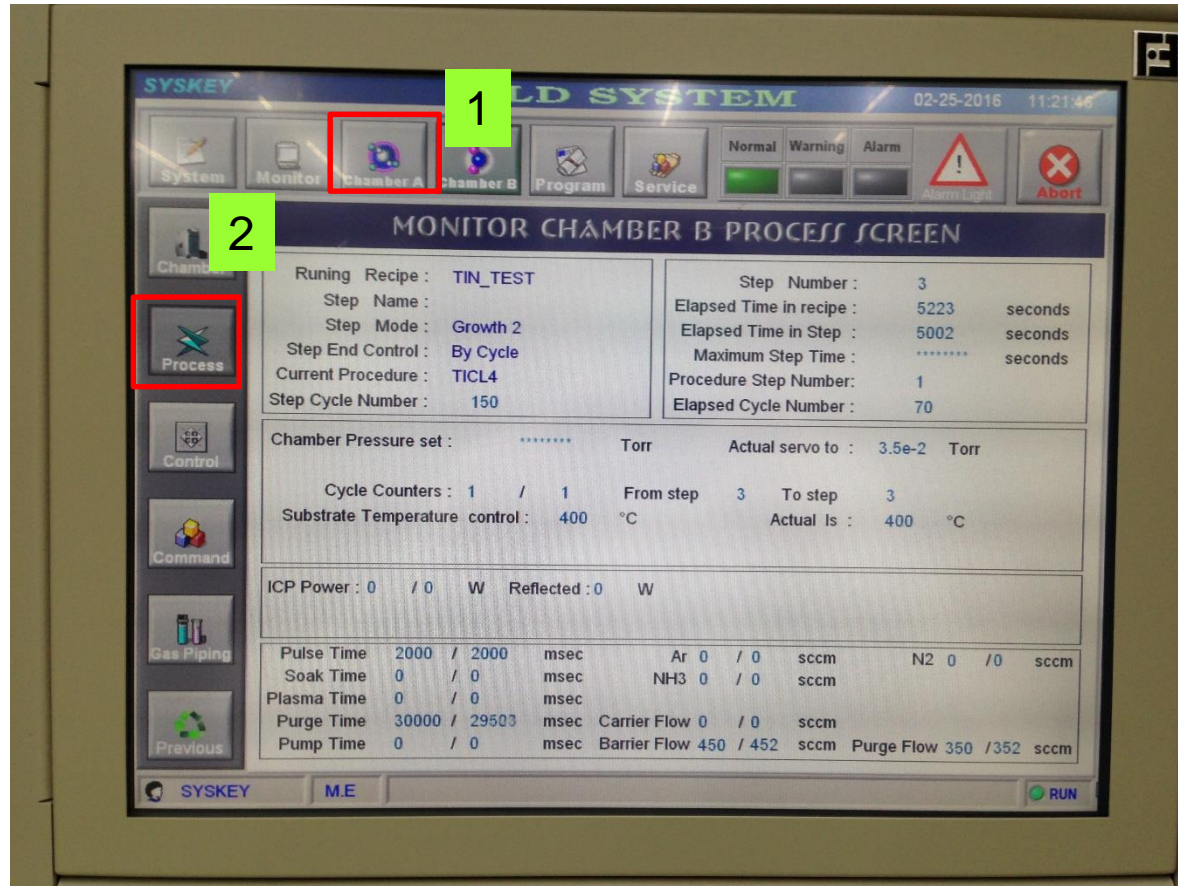


畫面二



1. 畫面一下方Chamber Process Program Selection方塊中，選擇Chamber A:____，出現畫面二程式下拉式選單。
2. 選擇所需執行程式名稱。
3. 確認所選擇程式正確，並點選Recipe確認。
4. 選擇“Recipe Run”執行程式。

製程即時監控



1. 點選功能選項目錄“Chamber A”。
2. 點選功能選項子目錄“Process”，進入Monitor chamber A process screen，即可即時監控制程進度。